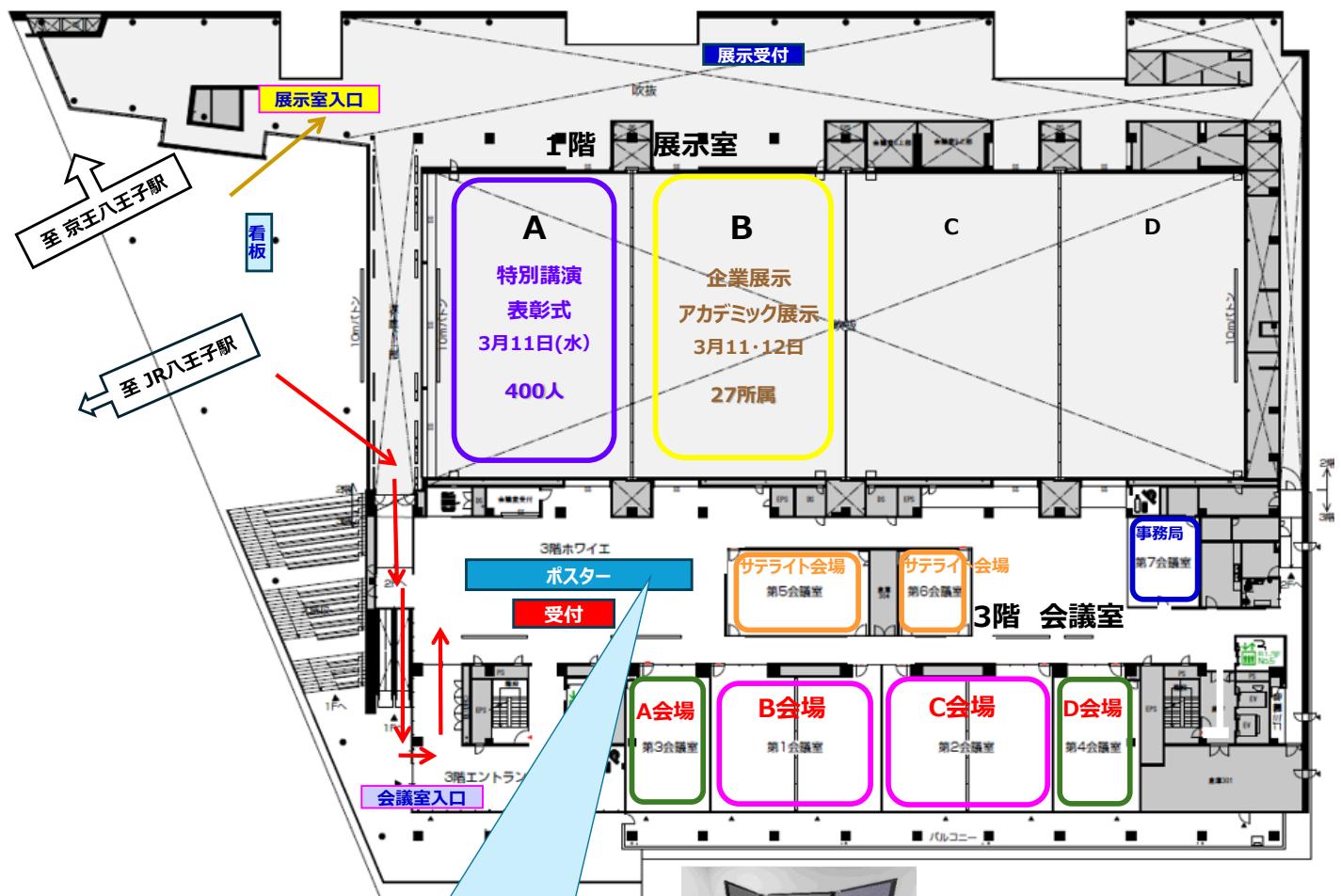


第40回エレクトロニクス実装学会春季講演大会 東京たま未来メッセ 会場レイアウト



ポスター会場：3階ホワイエ



コアタイム：11日(水)12:30～14:15
12日(木)12:30～13:45

【会議室】
三つ折りパーティション
W800+1,200+800×H1,800
mm
キャスター付

位置	PNo. (RNo.)	氏名（所属）	演題	12日A会場 ショートプレゼン
A	11P3-A (0014)	阪本 邦夫（甲南大学）	球形透明反射スクリーンを用いた空中映像表示システムMirage：とその応用	SP1
B	11P3-B (0133)	横山 真心（東京工芸大学）	豚生体を対象とした生体通信ネットワークにおける床面電極がつくる表面電流分布解析	SP2
C	11P3-C (0029)	神山 孝一（メイコー）	アルミニ配線多層基板	
D	11P3-D (0085)	丸田 博之（シミズ）	無電解めっき用電着オトレジスト	
E	11P3-E (0129)	松澤 浩彦（国研）	エレキCADを使ったパワーモジュール設計・検証	
F	11P3-F (0013)	岸野 真之（旭化成）	先端半導体パッケージ向け厚膜ドライフィルムレジストの開発	
G	11P3-G (0028)	内田 一幸（日鉄ケミカル＆マテリアル）	レーザー剥離用仮接着剤の開発	
H	11P3-H (0034)	佐藤 成嶺（群馬工業高等専門学校）	Sn-37.5mass%Bi合金の超塑性変形に及ぼす複合添加の影響	SP3
I	11P3-I (0045)	明石 七祐（群馬工業高等専門学校）	Sn-Bi合金の超塑性に及ぼすBi濃度と添加元素の影響	SP4
J	11P3-J (0117)	倉世古 紗美（東レ）	銅積層フィルムの銅膜質とガス透過性に関する検討	
K	11P3-K (0006)	桂 章皓（京都工芸繊維大学）	半導体/金属界面の接触抵抗の精密計測によるデバイス構造最適化	SP5
L	11P3-L (0084)	Wu Kejun（ウシオ電機）	Cu/SiO ₂ ハイブリッドボンディングの活性化における紫外線処理と真空プラズマ処理の比較	
M	11P3-M (0072)	菅原 彩（愛知製鋼）	無電解Co-Wめつきの車載用放熱部品への適用可能性検討	
N	11P3-N (0024)	佐藤 哲（東北工業大学）	アルカリ水溶液を用いたリチウムイオン二次電池の発火無効化装置の開発	SP6
O	11P3-O (0109)	藤原 理央（東京工芸大学）	大電力宇宙電気推進の研究開発に供する複数機作動実験設備の構築－スラスター並列作動実験－	SP7